

2019年度砥粒加工学会学術講演会 (ABTEC2019) セッションプログラム

【 第1日目:8月28日(水) 】

8.40	A室	B室	C室	D室	E室	F室	
9.00	トライボロジー(1)	ツールイン グ・ドレッシ ング技術	付加工 (アディティ ブ・マニュ ファクチャ リング)(1)	先端材料と その応用(1)	ファインパ ブル・ナノパ ブルとその 応用	先進切削加 工技術	
9.20		休憩					
10.00		超精密加工 装置の開発 と超精密加 工技術(1)					
10.40	休憩						
11.00	トライボロ ジー(2)	超精密加工 装置の開発 と超精密加 工技術(2)	付加工 (アディティ ブ・マニュ ファクチャ リング)(2)	先端材料と その応用(2)	切断・割断 加工(1)	加工機械の 高性能・高 機能化(1)	パネル・ カタログ 展示 談話室
11.40							
12.20	昼食						
13.00	研削現象の 基礎とモニ タリング(1)	医歯工学(1)	部品機能と 表面性状・ 形状の評価 (1)	先端加工計 測技術(1)	切断・割断 加工(2)	加工機械の 高性能・高 機能化(2)	
13.40							
14.00	研削現象の 基礎とモニ タリング(2)	医歯工学(2)	部品機能と 表面性状・ 形状の評価 (2)	先端加工計 測技術(2)	切断・割断 加工(3)	環境調和型 加工技術 (含.MQL)	
14.40							
15.00	学会活性化フォーラム (総合研究棟1Fシアター教室)						
16.20	学会活性化フォーラム (総合研究棟1Fシアター教室)						
20.00	学会活性化フォーラム (総合研究棟1Fシアター教室)						

【 第2日目:8月29日(木) 】

8.40	A室	B室	C室	D室	E室	F室	G室
9.00	研削現象の 基礎とモニ タリング(3)	医歯工学(3)	難削材・新 素材の加工 (1)	超砥粒砥 石・高機能 工具の開発 と応用(1)	超音波・振 動援用加工 (1)	マイクロ・ナ ノ加工(1)	先端半導体 材料の精密 加工(1)
9.40						休憩	
10.40	休憩						
11.00	研削現象の 基礎とモニ タリング(4)	医歯工学(4)	難削材・新 素材の加工 (2)	超砥粒砥 石・高機能 工具の開発 と応用(2)	超音波・振 動援用加工 (2)	マイクロ・ナ ノ加工(2)	先端半導体 材料の精密 加工(2)
11.40						休憩	
12.20	昼食						
13.40	我が社の新技術発表会 (A~E室)						
14.40	休憩						
15.00	学会活動報告会・贈賞式 (1号館3F 301教室)						
16.00	休憩						
16.20	特別講演 (1号館3F 301教室)						
17.20	移動						
18.00	懇親会 (第2食堂)						
20.00	懇親会 (第2食堂)						

【 第3日目:8月30日(金) 】

8.40	A室	B室	C室	D室	E室	F室	
9.00	ラッピング・ ポリッシング・ CMPの原理 と応用(1)	光・ビームに よる加工技 術(1)	工作機械の 知能化・ CAM(1)	磁界・電界 砥粒制御に よる次世代 加工技術(1)	技術・技能 教育(1)	プラスト・バ レル加工の 最前線(1)	
9.40							
10.40	休憩						
11.00	ラッピング・ ポリッシング・ CMPの原理 と応用(2)	光・ビームに よる加工技 術(2)	工作機械の 知能化・ CAM(2)	磁界・電界 砥粒制御に よる次世代 加工技術(2)	技術・技能 教育(2)	プラスト・バ レル加工の 最前線(2)	パネル・ カタログ 展示 談話室
11.40							
12.20	昼食						
13.40	奨励賞受賞者記念講演(1号館3F 301教室)						
14.40	休憩						
15.00	ラッピング・ ポリッシング・ CMPの原理 と応用(3)	光・ビームに よる加工技 術(3)	新砥粒の開 発と応用	高性能切削 工具の開発 と応用	技術・技能 教育(3)	ナノ精密・ ELID加工	
15.40							
16.00	休憩						
16.20	休憩						
17.20	休憩						
18.00	休憩						
20.00	休憩						

2019年度砥粒加工学会学術講演会(ABTEC2019)
第1日目(8月28日)(セッション名後はオーガナイザ名)

	A室	B室	C室	D室	E室	F室	
8:40							8:40
9:00	A01 【トライボロジー(1)】 (清水 淳, 平塚健一, 菅 洋志, 酒井康徳) 座長: 菅洋志, 清水淳 単結晶フッ化カルシウムの超精密切削加工における加工面品位評価と微小光共振器への応用 ○水本由達, 柿沼康弘(慶應義塾大学)	B01 【ツールイング・ドレッシング技術】 (岩井 学, 吉原信人, 佐藤隆之介) 座長: 吉原信人 レーザークリーニング援用ドレッシング法の研究 -第2報- レーザー条件の影響- 岩井学, ○西島涼(富山県立大学), 三羽和紀, 乾伸輔(NKワークス(株)), ニノ宮進一(日本工業大学)				F01 【先進切削加工技術】 (小川圭二, 関根 務, 杉原達哉) 座長: 小川圭二 マイクロボールエンドミルの振れ量を考慮した適切な回転数設定について ○隈元康一(千葉職業能力開発促進センター)	9:00
9:20	A02 アプレシブ磨耗面のRaman断面計測 (小貫哲平, 管駿輔, 長谷川暉輔, 金丸祐希, 尾高裕隆, 清水淳, 周立波(茨城大学))	B02 真空研磨法による電着砥石のツールイングに関する研究 ○坂本武司, 篠崎烈, 真島吉将(有明工業高等), 峠睦(熊本大学)	C02 【付加工(アディティブ・マニファクチャリング)(1)】 (阿部壮志, 山内友貴) 座長: 阿部壮志 C02 ファイバレーザを用いたレーザ焼結における寸法精度及び密度向上を目的とした供給エネルギーの最適化 ○村上祐一, 山内友貴, 大久保智(東京都立産業技術研究センター)	D02 【先端材料とその応用(1)】 (鈴木康久, 田中 浩) 座長: 鈴木康久 D02 形状記憶ポリマーフォームの押込み変形特性とその応用 ○竹倉大和, 武田亘平(愛知工業大学), 林俊一(株)SMPテクノロジー)	E02 【ファインパブル・ナノパブルとその応用】 (平井聖児, 岩井 学) 座長: 平井聖児 E02 脱泡によるウルトラファインパブルクーラントの数密度測定 ○渡辺剛, 高田亮, 深見信吾, 毛利茂樹(日本タンクス(株)), 平本謙(九州工業大学)	F02 幾何学的算法の違いが工具経路間隔に及ぼす影響の数値的検討 ○関根務(成蹊大学)	9:20
9:40	A03 分子動力学シミュレーションによるhpc結晶のアプレシブ磨耗の検討 ○矢野彦彦, 林旺票, 清水淳, 周立波, 小貫哲平, 尾高裕隆, 山本武幸(茨城大学)	**** 休憩 ****	C03 レーザ焼結部品の表面状態が部品の強度に及ぼす影響に関する研究 ○山内友貴, 木暮尊志(東京都立産業技術研究センター)	D03 サブループにおけるTiNi形状記憶合金の変態誘起クリープ回復 ○森史樹, 武田亘平(愛知工業大学)	E03 ファインパブルクーラントのパブル条件と加工性能の関係 -第2報-クーラント中のパブル状態- 安齋聡(株)安齋管鉄, 岩井学, 山下凌大, ○市川可奈子, 神谷和秀, 関口有輝(富山県立大学), ニノ宮進一(日本工業大学)	F03 高圧クーラントを用いたInconel 718の高速切削加工-CBN工具の材料組織構造の影響- ○劉奇鑫, 杉原達哉, 榎本俊之(大阪大学)	9:40
10:00	A04 すべりによる局所圧縮水圧が切削現象に及ぼす効果 ○清水淳, 周立波, 小貫哲平, 尾高裕隆, 矢野直彦, 山本武幸, 櫻井春菜(茨城大学)	B04 【超精密加工装置の開発と超精密加工技術(1)】 (鈴木浩文, 古城直道, 福田将彦, 森田晋也) 座長: 鈴木浩文 B04 鋼単結晶(111)の超精密切削機構に関する研究 ○古城直道, 廣岡大祐, 山口智実(関西大学)	C04 Directed Energy Deposition におけるワークの高さ測定に基づいた指令積層高さの設定と更新の方法 ○山口晴之, 河野大輔, 山路伊和夫(京都大学), 小田陽平(DMG森精機(株)), 松原厚(京都大学)	D04 cBN工具刃先のダイヤモンド砥粒及びSiC砥粒による研磨加工 ○田中浩(愛知工業大学), 川瀬恵嗣(株)小林機械製作所, 赤上陽一(秋田県産業技術センター)	E04 座長: 岩井学 加工圧解法で発生したマイクロパブルの基礎特性とその応用 ○平井聖児, 堀内勉, 香村誠(ものつくり大学), 青木繁, 池田宏, 栗田勝美(東京都立産業技術高等)	F04 低エネルギーイオンビームによる単結晶ダイヤモンド工具の鋭利化 ○大野威徳(帝京大学)	10:00
10:20	A05 AE法を用いた工具すくい面で生じるトライボロジー現象のインプロセス計測 -Inconel 718の旋削加工におけるCBN工具の磨耗過程の認識- ○長谷重蘭(埼玉工業大学), 杉原達哉(大阪大学)	B05 高精度非接触レーザ変位計を用いた超精密加工機の機上計測 ○段英, 森田晋也(東京電機大学), 細島拓也, 竹田真宏, 山形聖(理化学研究所)	C05 指向性エネルギー堆積法におけるInconel 625造形物の疲労強度および衝撃強度の評価 ○小池綾, 柿沼康弘, 鈴木哲也(慶應義塾大学), 小田陽平(DMG森精機(株))	D05 高強度ハイドロゲルのレーザ加工断面における摩擦挙動 ○和田真人(鶴岡工業高等), 吉田一成, 川上勝(山形大学), 足立幸志(東北大学), 古川英光(山形大学)	E05 数値流体力学による加工圧解法マイクロパブルの発生条件の解析 ○堀内勉, 香村誠, ビチャイサチュヤ, 平井聖児(ものつくり大学)	F05 透明樹脂導光体の加飾切削加工に関する研究 -ストライプ模様での基礎的検討- ○小川圭二, 橋巧也(龍谷大学), 今田琢巳(滋賀県工業技術総合センター), 世良哲也, 岡部輔(株)エイコー(株)	10:20
10:40	**** 休憩 ****						10:40
11:00	A06 【トライボロジー(2)】 座長: 清水淳 砥粒と材料表面の干渉で生じるトライボロジー現象とAE信号 -潤滑下の固定砥粒と遊離砥粒を用いた摩擦実験- ○長谷重蘭(埼玉工業大学)	B06 【超精密加工装置の開発と超精密加工技術(2)】 座長: 森田晋也 自由曲面加工に関するプロセスと生産性の検討 ○渡邊賢太郎, 土屋康二, 室伏真, 福田将彦(東芝機械(株))	C06 【付加工(アディティブ・マニファクチャリング)(2)】 座長: 山内友貴 C06 指向性エネルギー堆積型AMと切削による複合加工のための工程設計法の開発 ○片岡倫明, 阿部壮志, 金子順一, 堀尾健一郎(埼玉大学)	D06 【先端材料とその応用(2)】 座長: 田中浩 D06 前駆体を被覆した複合ファイラーによるレジソンド砥石の分散性改善 ○佐々木正太(秋田県立大学), 泉妻孝迪, 大津加慎教(山形県工業技術センター), 鈴木康久, 藤井達也, 野村光由(秋田県立大学)	E06 【切断・割断加工(1)】 (諏訪部仁, 松坂壮太, 留井直子, 坂本 智) 座長: 諏訪部仁 E06 ワイヤソーによる溶射被膜の微細加工 ○藤岡和史, 坂本智(横浜国立大学), 山口貢(東京大学), 荒川進(長野県南信工科短期大学), 近藤康雄(山形大学), 山口鎮司(米子工業高等)	F06 【加工機械の高性能・高機能化(1)】 (藤本正和, 由井明紀, 三浦弘幸, 廣塚俊樹) 座長: 廣塚俊樹 F06 桌上型5軸NC精密研削盤の試作と精度測定 ○佐藤芳紀, 藤本正和, 田嶋良佑, 大石直(青山学院大学)	11:00
11:20	A07 超音波が塑性加工時に生じる加工力及び摩擦特性に及ぼす影響の解明 ○劉士豪(東京工業大学), 酒井康徳(芝浦工業大学), 田中智久(東京工業大学), 青木繁(東京都立産業技術高等)	B07 無電解Ni-Pめっきの材料特性の評価 ○中川恒裕, 岡田睦, 鈴木浩文, 加藤章(中部大学), 池田安生(株)ナクロ	C07 ワイヤ+アーク放電によるAMを用いた中実形状造形のための積層条件決定支援ソフトウェアの開発 ○井口玲良, 阿部壮志, 金子順一, 堀尾健一郎(埼玉大学)	D07 カーボンナノチューブ複合フェノール樹脂を用いたレジソンド砥石の研削性能 ○佐々木智音, 大谷文, 鈴木康久, 藤井達也, 野村光由(秋田県立大学)	E07 結晶材料のホイール割断において結晶面が亀裂進展におよぼす影響 ○高林謙, 松本祐一, 松坂壮太, 比田井洋史, 千葉明, 森田昇(千葉大学)	F07 長尺内面研削スピンドルの開発に関する研究 -第9報- 高速主軸用中空シャフトの残留不つき合いによる軸振れおよび軸受応力の予測 ○安達和彦(中部大学), 大久保信雄, 大久保元博(大久保精工(株)), 向井良平(三井精機工業(株)), 高橋宏美(株)豊幸	11:20
11:40	A08 駆動体接触状態が転がり案内の振動及び摩擦特性に及ぼす影響 ○酒井康徳(芝浦工業大学), 田中智久(東京工業大学)	B08 超音波振動援用プレス加工による微細テクニカル加工 ○鈴木智大, 鈴木隆世, 岡田睦, 鈴木浩文(中部大学), 伊藤洋介, 藤井一(日進工具(株)), 加藤英治(加藤歯科インプラントセンター)	C08 造形物温度がアルミニウム造形物内部の水素細孔に与える影響 ○永松秀明, 菅原弘之(東京農工大学), 阿部壮志(埼玉大学)	D08 カーボンナノチューブ被覆によるダイヤモンドレジソンド界面接着性の向上 ○後藤晃哉, 高橋辰宏(山形大学), 鈴木康久(秋田県立大学)	E08 ガラスのレーザ割断における光弾性法による内部応力の検討 ○岩月謙志, 比田井洋史, 千葉明, 松坂壮太, 森田昇(千葉大学)	F08 研削盤の高性能・高機能化への取り組み ○吉田裕(株)岡本工作機械製作所	11:40
12:00	A09 直動ガイドにおける駆動体の挙動観察 ○大関浩(千葉工業大学)	B09 PCO工具の精密研削 -インプロセスドレッシングの影響- ○鈴木太一, 大橋怜央, 尾坂祐人, 鈴木浩文, 岡田睦(中部大学), 福西利夫, 浅井義之(三星ダイヤモンド工業(株))	C09 FDM3Dプリント部品の表面処理のためのプラスト研削条件の検討 ○SantosGustavo, 金子順一, 阿部壮志, 堀尾健一郎(埼玉大学)	D09 レーザによるダイヤモンド内部異物に対する通電加熱および抵抗値の温度依存性計測 ○徳永大太郎, 比田井洋史, 松坂壮太, 千葉明, 森田昇(千葉大学)	E09 ワイヤ工具によるサファイア切断の研究 -加工メカニズム解析による高効率化の検討- ○森山勉也, 矢澤孝哲, 大坪樹(長崎大学)	F09 センサーフィードバック垂直多関節ロボットアームシステムによる高効率化の検討 ○柳原聖, ○堀崎樹, 松村俊弥, 明石剛二(有明工業高等)	12:00
12:20	**** 昼食 ****						12:20

パネル展示・研究公開・カタログ展示

13:00	<p>【研削現象の基礎とモニタリング(1)】 (大橋一仁、水谷秀行、山田高三) 座長：山田高三 A10 ハイレシプロ研削による難削材の研削 ○吉原信人、小野雅生、西川尚宏、水野雅裕(岩手大学)</p>	<p>【医歯工学(1)】 (佐藤秀明、矢澤孝哲、亀山雄高) 座長：佐藤秀明 B10 新規バイオセラミックス窒化ケイ素の医療分野への応用 ○足立哲也、堀口智史、山本 俊郎(京都府立医科大学)、Giuseppe Pazzotti(京都工芸繊維大学)、金村成智(京都府立医科大学)</p>	***** 昼 食 *****			
13:20	<p>A11 CFRPの研削加工に及ぼす研削雰囲気の影響 ○岡崎良吾、江一帆、児玉藍香(岡山大学)、余田裕之(岡山県工業技術センター)、大橋一仁(岡山大学)</p>	<p>B11 Ti-Nb-Cu合金の研削加工性と機械的性質 ○高橋正敏、高田雄京(東北大学)</p>	<p>【先端加工計測技術(1)】 (浅川直紀、林照剛、水谷康弘、伊東 聡) 座長：林照剛 D11 レーザ微細加工におけるインプロセスモニタリングの研究 ○今井克之、山田洋平、池野順一(埼玉大学)</p>	<p>【切断・割断加工(2)】 座長：坂本 智 E11 ホイール割断における荷重荷時のガラス内部応力推定 ○今井健太郎、松本祐一郎、松坂壮太、比田井洋史、千葉明、森田昇(千葉大学)</p>	<p>【加工機械の高性能・高機能化(2)】 座長：藤本正和 品質工学に基づく対向主軸NC旋盤のワーク自動排出生産の開発 ○山口陽平、石黒春樹(DMG森精機(株))、廣垣俊樹、青山栄一(同志社大学)</p>	
13:40	<p>A12 低硬質砥粒と高硬質砥粒を同時に用いた複合同時研削時の研削面観察 ○巖野広明、野老山貴行、梅原徳次、村島基之(名古屋大学)、千葉翔悟((株)齊藤光学製作所)</p>	<p>B12 Ti-5¹mass%Fe合金の耐摩耗性 ○山口洋史、高橋正敏、佐々木啓一、高田雄京(東北大学)</p>	<p>【部品機能と表面性状・形状の評価(1)】 (吉田一朗、高橋正明、三浦勝弘) 座長：岡田将人 C12 上下両面測定対応表面形状粗さ測定機の開発 ○西川洋太、熊谷智晴(アメテック(株))</p>	<p>D12 顕微Raman断層計測によるサファイア研削面損傷の評価 管駿輔、○小貫哲平、東瀬大知、尾島裕隆、清水淳、周立波(茨城大学)</p>	<p>E12 ガラスへのホイール割断用工具押付による亀裂生成・進展挙動の観察 ○浅利朋生、松本祐一郎、松坂壮太、比田井洋史、千葉明、森田昇(千葉大学)</p>	<p>F12 研削盤砥石カバターの衝突安全性に関する研究ーカッター材の引張試験に基づく安全性予測ー ○楢井拓哉(防衛大学校)、由井明紀(神奈川大学)、北嶋孝之(防衛大学校)</p>
14:00	<p>A13 周波数解析を用いた研削焼け監視プロセスの検討 ○田中秀明、河野武尊(湘南工科大学)</p>	<p>B13 斜射投影粒子ビーミングを施したチタンの表面形状が細胞接着性および増殖性に及ぼす効果 ○鈴木季奈、桃沢愛(東京都立大学)、照月大悟(東京都立大学)、亀山雄高、遠山沙良、高橋玄宇(東京都立大学)</p>	<p>C13 複合繊維材料(CFRP)を用いた積層造形品に対する積層及び切削条件の検討 ○神宮雄大、金子順一、阿部壮志、堀尾健一郎(埼玉大学)</p>	<p>D13 ヘリカル補間スレッドミルのねじ切りの工具回転率抽出に関する研究 ○松井翔太、尾崎信利、廣垣俊樹、青山栄一(同志社大学)、松田友(株)山本金属製作所</p>	<p>E13 樹脂コーティングワイヤソーの加工メカニズムに関する研究ーワイヤに食込むダイヤモンド砥粒ー ○伊藤大貴、諏訪部仁、石川憲一(金沢工業大学)</p>	<p>F13 ビルトインモーター スピンドルの最適冷却条件に関する研究ー第1報：ビルトインモータスピンドルの温度変化シミュレーションー 楠山純平、小松泰絵、橋本匠海、○榎田雅介、中尾陽一(神奈川大学)</p>
14:20	<p>A14 ロータリ型インフィード平面研削メカニズムに関する研究ー無線式温度計測器の開発と研削温度の評価ー ○石橋憲、市川優希、周立波、清水淳、山本武幸、小貫哲平、尾島裕隆(茨城大学)</p>	<p>B14 マイクロ・ナノパターンに対する血液関連細胞の細胞接着 ○赤坂司(北海道大学)</p>	<p>C14 精密計測ロボットに関する研究ー第1報：電磁石を用いた計測精度を向上させた精密計測ロボットの振動解析による精度向上要因の検証ー ○田中一秀、吉田一朗(法政大学)</p>	<p>D14 AEセンサを用いたエンドミルコーナ部のチップング検出に関する研究 ○齋藤賢人、加藤和弥(湘南工科大学)、野村亜未、内海幸治(株)日立製作所</p>	<p>E14 ガラスのホイール割断において湿度が亀裂進展挙動におよぼす影響 ○染野凌汰、松本祐一郎、松坂壮太、比田井洋史、千葉明、森田昇(千葉大学)</p>	<p>F14 工作機械用温度制御システムの開発と制御性能の基礎的評価 ○小高勢也、川瀬美真、楠山純平、中尾陽一(神奈川大学)</p>
14:40	***** 休憩 *****					
15:00	<p>【研削現象の基礎とモニタリング(2)】 座長：水谷秀行 A15 単一砥粒に作用する研削抵抗からみたクリープフィード研削機構 ○藤本正和(青山学院大学)、梅田拓実((株)アマダ)、大石進(青山学院大学)</p>	<p>B15 【医歯工学(2)】 座長：江面篤志 歩行アシストスーツを用いた負荷増大トレーニング法の提案 ○宮崎哲郎、川瀬利弘、菅野貴晴、川嶋健嗣(東京医科歯科大学)</p>	<p>【部品機能と表面性状・形状の評価(2)】 座長：岡田将人 C15 プラトー表面の表面粗さ評価法に関する研究ー最小有差法を用いたプラトー構造が十分に創成されていない表面のための解析法の開発ー ○榎原優、吉田一朗、近藤雄基(法政大学)、山下健一(株)いすゞ中央研究所</p>	<p>【先端加工計測技術(2)】 座長：伊東聡 D15 A nano-indentation system for precision measurement of a single point diamond tool ○張凱、XuMalu, CaiYindi、松隈啓、清水裕樹、高偉(東北大学)</p>	<p>【切断・割断加工(3)】 座長：松坂壮太 E15 マルチワイヤー放電加工機を用いたSiC インゴット量産加工技術 ○柴田文雄(キヤノンマーケティングジャパン(株))</p>	<p>【環境調和型加工技術(含、MQL)】 (二ノ宮進一、大西 孝、西川尚宏、佐藤連海) 座長：二ノ宮進一 F15 フッリン酸ガラスの表面に及ぼす電解水の影響 ○佐藤連海、川久保英樹(信州大学)、馬場隆亮(株)ニト</p>
15:20	<p>A16 内面研削における砥石の形状補正を用いた微小テーパー加工法の開発 ○大西孝、中林優介(岡山大学)、坂倉守昭(大同大学)、大橋一仁(岡山大学)</p>	<p>B16 生体由来組織の加工による機能性材料の開発 ○橋本良秀、門田純平(東京医科歯科大学)、松本誠一(大阪工業大学)、木村剛、岸田晶夫(東京医科歯科大学)</p>	<p>C16 静圧空気軸受における回転誤差と軸形状ーマルチステップ法の実用化に向けた評価法の確立ー ○富田宏貴(東京都立産業技術高等)、高橋正明(ものつくり大学)、小泉孝一(株)三鷹精工</p>	<p>D16 蛍光ナノプローブを用いたCMPスラリー中の砥粒粒度分布計測に関する研究 ○赤星圭将、林照剛、黒河周平、松川洋二(九州大学)</p>	<p>E16 レーザスライシング技術を用いたMgOウエハのスライス加工 ○山田洋平、池野順一(埼玉大学)、野口仁(信越化学工業(株))、鈴木秀樹(信越ポリマー(株))</p>	<p>F16 電気防錆加工システムの研究開発ー水加工システム導入と機関共同研究展開検討ー ○西川尚宏(岩手大学)、後藤展男、千葉幸男((有)シー・エフ・トップ)、飯田勇気、中居久明(青森県産業技術センター)、澤武一(芝浦工業大学)、吉原信人、萩原義裕、水野雅裕(岩手大学)、塚本真也(中国職業能力開発大学校)</p>
15:40	<p>A17 多糸ドレス砥石の研削メカニズムの研究 第1報：糸数による砥石面形状と研削抵抗の関係 ○市原浩一(住友重機械工業(株))</p>	<p>B17 粒子形態情報と顕微ラマン分光法の複合解析による医薬品分析事例 ○早内愛子、笹倉大智(スペクトリス(株))</p>	<p>C17 ポイントオフトフォーカス法による歯車測定における傾斜角度に対する表面性状特性 ○三浦勝弘、能勢敦子、古田島秀夫、塚本貴雄(三鷹光器(株))</p>	<p>D17 無線ホルダシステムを用いた主軸状態診断と加工現象モニタの考察 ○山本隆将、松田亮、新堂正俊(株)山本金属製作所、廣垣俊樹、青山栄一(同志社大学)</p>	<p>E17 新加工法「スクライプ+ブレイク」による硬脆材料基板の切断 ○飯田純平、留井直子、村上健二、福西利夫(三星ダイヤモンド工業(株))</p>	<p>F17 レジンボンドダイヤモンド砥石のSFツールイングに及ぼすウルトラファイナパールの効果 二ノ宮進一、○栗田隼、山田庸二(日本工業大学)、岩井学(富山県立大学)</p>
16:00	***** 休憩 *****					
16:20	<p>学会活性化フォーラム 講演会・贈賞式 (総合研究棟1Fシアター教室) 16:20~17:30 講演「信じれば光る ～開発技術を産業利用するための思考術～」 理化学研究所 大森素形材工学研究室 主任研究員、埼玉大学大学院 理工学研究科 連携教授 大森 整先生 17:30~18:00 企業賞 贈賞式</p>					
18:00	<p>学会活性化フォーラム 交流会 (けやき会館(第1食堂))</p>					
20:00						

パネル展示・研究公開・カタログ展示

13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
18:00
20:00

2019年度砥粒加工学会学術講演会 (ABTEC2019)
第2日目(8月29日) (セッション名後はオーガナイザ名)

	A室	B室	C室	D室	E室	F室	G室	
8:40						【マイクロ・ナノ加工(1)】 (松井伸介、松村 隆、天本祥文、布引雅之) 座長：布引雅之 F18 超硬合金製マイクロレンズアレイ型の加工 ーNPD製研削工具の切れ味と耐久性ー ○仙波卓弥、天本祥文(福岡工業大学)、角谷均(住友電気工業(株))	【先端半導体材料の精密加工(1)】 (加藤智久、河田研治、黒川周平) 座長：河田研治 遊離砥粒加工を用いた極細線ワイヤーでの高線速切断の可能性 ○植村泰保樹、米田竜也(株)タカトリ、加藤智久(産業技術総合研究所)	8:40
9:00	A19 【研削現象の基礎とモニタリング(3)】 座長：大橋一仁 砥石投影画像を用いた砥石作業面上の切れ刃分布測定 ○平野育海、内田元、李和樹、山田高三、三浦浩一(日本大学)	B19 【医歯工学(3)】 座長：亀山雄高 キャビテーション噴流による口腔バイオフィルム除去 ○山田純輝、滝口尚(昭和大学)、祖山均(東北大学)、山本松男(昭和大学)	C19 【難削材・新素材の加工(1)】 (北嶋孝之、静 弘生、高松浩司) 座長：北嶋孝之 C19 難削材の高速ミリング特性 ー第1報：チタン系材料における切削条件の適正化ー ○神長千愛希、Therdak JAINGAM、澤武一、安齋正博(芝浦工業大学)	D19 【超硬砥石・高機能工具の開発と応用(1)】 (澤 武一、山口桂司、永橋潤司) 座長：山口桂司 D19 ガラス研削用弾性砥石に関する研究 ○坂本愛、森和生、山田洋平、池野順一(埼玉大学)、阿部健、真野稔正(アイオン(株))	E20 【超音波・振動援用加工(1)】 (神 雅彦、今井健一郎、磯部浩巳) 座長：神雅彦 E20 超音波研削加工において砥石振動がガラスの内部応力に与える効果 ○磯部浩巳(長岡技術科学大学)、原圭祐(一関工業高等)	F19 ナノインデンテーションによる部分安定化シリコニアの相変態挙動に関する研究 ○香西孝司、間紀旺(慶應義塾大学)	G19 SiCウエハの高効率研削における電界スラリー制御研削を用いた均一研削の検討 ○久住孝幸、越後谷正良、中村寛太、大久保義真、赤上隆一(秋田県産業技術センター)、河田研治、加藤智久(産業技術総合研究所)	9:00
9:20	A20 砥石表面形状測定によるドレッシング前後での砥粒分布の定量的評価 内田元、○岩崎佑太、山田高三、三浦浩一(日本大学)	B20 Diamond-like carbonのバイオフィルム付着抑制効果 ○石輪浩志、真柳弦(東北大学)、佐藤秀明(東京都立大学)、吉川亮太、藤本佑典(株)野村鍍金)、高橋信博、山田聡(東北大学)	C20 インコネル718の高効率加工に関する研究 ー切削速度と送り速度が工具に及ぼす影響ー ○三田賢也、川崎一正(新潟大学)	D20 鏡面研削のための熱可塑性樹脂砥石用ドレッサーの開発 ○津田雄一郎、川崎裕郎、丹勇人、佐々木ひかる、松浦寛(東北学院大学)、葉崎理(株)ファーストクラスライド)	E20 【超音波・振動援用加工(1)】 (神 雅彦、今井健一郎、磯部浩巳) 座長：神雅彦 E20 超音波研削加工において砥石振動がガラスの内部応力に与える効果 ○磯部浩巳(長岡技術科学大学)、原圭祐(一関工業高等)	F20 AFMスクラッチ加工による研削加工特性評価ーアルミナ触針による加工特性ー ○赤坂孝幸、松井伸介(千葉工業大学)	G20 フェムト秒レーザ照射されたSiC 基板のCMP研削特性 ○黒川周平、王成武、林照剛(九州大学)	9:20
9:40	A21 乾式研削時における砥石外周形状の評価 ○井下田雅斗、内田元、山田高三、三浦浩一(日本大学)、高橋宏美(株)豊幸)、向井良平(三井精機工業(株))	B21 マイクロpHセンサーによる定量う蝕診断 ○田畑美幸、Chindana Ratanaporncharoen、北迫勇一、池田正臣、合田達郎、松元亮、田上順次、宮原裕二(東京医科歯科大学)	C21 NiTi超弾性合金の切削加工特性に関する研究 ー相比の違いが加工特性に及ぼす影響ー ○榎岡、酒井克彦、静弘生(静岡大学)、永禮哲生(沼津工業高等)、早川邦夫(静岡大学)	D21 PELDIによる複合砥粒ファイバード砥石の製作技術 ○山本太輝、伊藤伸英、飯沼亮介、櫻村聡、福澤勝史(茨城大学)、大森整(理化学研究所)	E21 フレキシブルステージを用いた超音波振動援用研削による超硬合金の穴あけ加工 ○寺町亮則(慶應義塾大学)、ターヴァイネンさゆり(有)アリュース)、間紀旺(慶應義塾大学)	F21 小型研削機によるSiC基板の研削特性の評価(第2報) ーpH変化と酸化剤の効果ー ○鈴木拓郎、松井伸介(千葉工業大学)、矢島利康、二宮大輔(丸石産業(株))	G21 バフの摩擦を利用したSiCの砥粒レス高速研削加工に関する研究 ○山田功太郎、山田洋平、池野順一(埼玉大学)、阿部健、真野稔正(アイオン(株))	9:40
10:00	A22 精密数値化された形状情報を用いたダイヤモンド砥粒の分類 第3報 ○菊田勝文、小杉剛(株)グローバルダイヤモンド)、早内愛子、笹倉大督(スペクトリス(株))	B22 整形外科用インプラント表面への各種ストロンチウムアパタイトのレーザー溶着加工と骨形成促進作用に関する検討 ー第三世代の整形外科用インプラントに向けてー ○吉川彰、赤羽学、川崎佐智子、吉良務、田中康仁(奈良県立医科大学)	C22 鉛フリー真鍮の小径穴あけ加工に関する研究 ー相比の違いが加工特性に及ぼす影響と切りくず排出機構の解明ー ○坪口渡悟、加藤秀治(金沢工業大学)、岡尚之(三菱愛研(株))	D22 メカノケミカル砥石を用いた水溶性油超仕上げ加工性能の調査 ○角田勝俊、棚田憲一、石井庸彦(株)ミズホ)、奥住陽介(日本グリース(株))	E22 AI203セラミックスの超音波振動援用研削加工における研削効率 ○西川将史、今井健一郎(神奈川工科大学)	F22 紫外線照射・小型研削機による酸・アルカリの効果と評価 ○上田大成、松井伸介(千葉工業大学)、矢島利康、二宮大輔(丸石産業(株))、山本栄一(株)岡本工作機械)	G22 溶融NaOHを用いたSiCの高効率研削 ○池永幸平、山火公貴、山田洋平、池野順一(埼玉大学)	10:00
10:20	A23 粒子形態情報と顕微鏡分光法の複合解析による、ダイヤモンド砥粒の物性予測に関する可能性検討(3) ○早内愛子、笹倉大督(スペクトリス(株))、小杉剛、菊田勝文(株)グローバルダイヤモンド)	B23 歯科用接着材料の技術について ○坂本猛(YAMKIN(株))	C23 放電加工層を有する超硬合金切削におけるマイクロバルクラントの有用性 ○吉田海希、宮本猛(神戸市立工業高等)	D23 CVDダイヤモンド砥粒を用いたホイールの開発とその加工特性 ○小松善弥(工学院大学)、畠山聡、江口國康(インターナショナルダイヤモンド(株))、西村一仁(工学院大学)	E23 SUS316への超音波振動援用ドリル加工におけるバリ抑制メカニズム ○田口恭輔(岩手大学、一関工業高等)、吉原信人(岩手大学)、原圭祐(一関工業高等)、水野雅裕(岩手大学)	***** 休憩 *****		10:20
10:40	***** 休憩 *****					【マイクロ・ナノ加工(2)】 座長：松村隆 F24 微細溝加工におけるバリ抑制およびエッジ品質向上に関する研究 ○藤本真也、布引雅之(兵庫県立大学)、奥田孝一(兵庫県立但馬技術大学校)	【先端半導体材料の精密加工(1)】 座長：加藤智久 G24 SiCウエハ加工変質層における歪み分布と微細構造の相関 ○若本享(ジェフテクノリサーチ(株))、瀬川悟志(旭ダイヤモンド工業(株))、井本恵子、先崎純寿、加藤智久、児島一聡、奥村元(産業技術総合研究所)	10:40
11:00	A25 【研削現象の基礎とモニタリング(4)】 座長：児玉益幸 ディープラーニングを用いたCBN砥粒の形状評価 ○岩橋祐輝、坂口彰浩、川下智幸、松尾修二、岩永雄大、山下豪輝(佐世保工業高等)	B25 【医歯工学(4)】 座長：矢澤孝哲 歯科補綴物製作のための焼成ジルコニア直接加工の研究 第1報：研削油の検討 ○土肥学、矢澤孝哲、大坪樹(長崎大学)、黒岩恵(株)恵夢工房)	C25 【難削材・新素材の加工(2)】 座長：静弘生 オゾンガス援用研削によるGaN基板の高効率平坦化 ー基礎加工特性の調査ー ○久保田章亀(熊本大学)	D25 【超硬砥石・高機能工具の開発と応用(2)】 座長：澤武一 D25 POD ブレードを用いた超硬合金製マイクロフォーミング工具の製作 ○杉本匠、高谷和也、山口桂司、江頭快、太田稔(京都工芸繊維大学)	E25 【超音波・振動援用加工(2)】 座長：今井健一郎 E25 超音波ヘリカルクス研削による小径軸付砥石の砥粒軌跡制御に関する研究 山田雄二、○石川光祐(日本工業大学)、岩井孝(富山県立大学)、二宮道一(日本工業大学)	F25 CO ₂ 雰囲気におけるTi合金(Ti-6Al-4V)のマイクロエンドミル加工特性 ○藤尾将司、布引雅之(兵庫県立大学)、奥田孝一(兵庫県立但馬技術大学校)	G25 AFMを利用したSiCウエハ表面の微細除去加工 ー加工痕のSEM、TEM、MEM、SART観察による潜傷発生限界の調査ー ○河田研治(産業技術総合研究所)、迫秀樹(株)東レリサーチセンター)、若本享(JFEテクノリサーチ(株))、声田穂、加藤智久(産業技術総合研究所)	11:00
11:20	A26 ディープラーニングを用いたCBN工具作業面性状の評価 ○山下豪輝、坂口彰浩、川下智幸、松尾修二、岩永雄大、岩橋祐輝(佐世保工業高等)	B26 歯面用軟質裏層材の研削の研究 ○米田隼人、佐藤秀明(東京都立大学)、山田哲二(メゾテックダイヤ(株))、亀山雄高、眞保良吉(東京都立大学)、木村拓雅(株)ジーシー)	C26 単結晶SiCの微細切削における工具切れ刃様丸みの影響 ○関屋翔一朗、北嶋孝之(防衛大学校)、由井明紀(神奈川大学)	D26 ナノファイバーパッド開発を目指した研削特性の検討 ○呉鏡、千草、青山栄一、廣理俊樹(同志社大学)、ト部賢一、曾田浩義(エム・テックス(株))	E26 高硬度前性材料の超音波振動研削に関する基礎的研究(第5報) ー研削機構の解析ー 神雅彦、○坂本慈瑛(日本工業大学)、金井秀生(株)industria)	F26 ナノ粒子を介在させたレーザ微細加工 ○山田海、山田洋平、池野順一(埼玉大学)	G26 SiCウエハのUVレザを用いた潜傷探査に関する研究 ○田口隆一、山田洋平、池野順一(埼玉大学)	11:20
11:40	A27 ディープラーニングを用いたダイヤモンドワイヤ表面の砥粒分散状態の分類 ○岩永雄大、坂口彰浩、川下智幸、松尾修二、岩橋祐輝、山下豪輝(佐世保工業高等)	B27 歯科用コンポジットレジンの乾式精密研削 ○米田隼人、佐藤秀明(東京都立大学)、山下哲二(メゾテックダイヤ(株))、亀山雄高、眞保良吉(東京都立大学)、木村拓雅(株)ジーシー)	C27 吸引プラズマ法を用いた半導体材料の局所深掘り加工技術 ダイアフラム構造の作製 ○野野諒、新堀俊一朗、高橋賢(株)三友製作所)、菅洋志(千葉工業大学)、久保利隆、安藤洋、清水哲夫、宮脇洋(産業技術総合研究所)	D27 CBN研削における砥粒特性が研削性能に及ぼす影響 ○松尾和昭、春日智行、相馬伸司、大久保聡、吉見隆行(株)ジェイテクト)	E27 超音波振動切削による表面特性向上技術の開発 ○渡邊幸一、水谷秀行(中部大学)	F27 摺動速度を変化させたコーティング膜の摩擦摩擦特性 ー旋盤の送り機構を用いた摩擦摩擦試験と実切削との相関性ー ○福島達也、高野登、伊野健太(富山大学)	G27 ミラー電子式検査装置を用いたエビレディ4H SiC 基板表面の非破壊評価 ○長谷川正樹、大平健太郎、栗岡剛幸、尾方智彦、小貫勝則、小林健二(株)日立ハイテクノロジーズ)、山内秀、井本恵子、先崎純寿(産業技術総合研究所)	11:40
12:00	A28 ベルト研削における砥粒分散性のエントロピーの評価 第3報:砥粒分布の計測の自動化 ○伊藤郁也、幸石泰文、萩原親作(山梨大学)	B28 安全な歯科治療への挑戦:物性を自在に操作できる印象法の開発 ○丹原隆、大森裕子、三俣哲、川合巴佳、高橋功次朗、齋藤功(新潟大学)	C28 統計的手法を用いたMEMS用圧電機材料の成長条件探索 ○樋谷和義(東海大学)	D28 新しいPOD エンドミルにおける切りくず生成に関する基礎的研究(第2報) 焼入れステンレス鋼の切削 ○ピラホンスリヤ(日本工業大学)、渡辺健志、後藤隆司(日進工具(株))、神雅彦(日本工業大学)	E28 砥石半径方向の超音波振動を援用した小径内面ホーニングの研究 ○渡邊友貴、水谷秀行(中部大学)、水野義則(株)日進製作所)、浜田晴司(多賀電気(株))	F28 集束イオンビーム照射した単結晶ダイヤモンド工具の改質とその切削加工特性 ー第6報:エンドミル工具におけるチクスカ効果の検討ー ○柳村公平(富山大学)、川塚宣隆(富山県)、高野登(富山大学)、森田祥(千葉大学)、西村一仁(工学院大学)、山口誠(秋田大学)	G28 SiC基板に存在する加工ダメージのエピタキシャル膜への影響評価 ○井本恵子、先崎純寿(産業技術総合研究所)、長谷川正樹、大平健太郎(株)日立ハイテクノロジーズ)、児島一聡(産業技術総合研究所)、小林健二(株)日立ハイテクノロジーズ)、奥村元(産業技術総合研究所)	12:00

パネル展示・研究公開・カタログ展示

12:20	****昼食****	12:20
13:20	我が社の新技術発表会 (A~E室)	13:20
14:40	**** 休憩 ****	14:40
15:00	学会活動報告会・贈賞式 (1号館3F 301教室)	15:00
16:00	**** 休憩 ****	16:00
16:20	特別講演 (1号館3F 301教室) 「Suicaが世界を変える！」～新しい社会インフラ創造への挑戦～ JR東日本メカトロニクス株式会社 取締役会長 椎橋章夫氏	16:20
17:20	**** 移動 ****	17:20
18:00	懇親会 (第2食堂) 「BONSAI」 (さいたま市の文化) 紹介 山田香織氏	18:00
20:00		20:00

パネル展示・研究公開・カタログ展示

2019年度砥粒加工学会学術講演会(ABTEC2019)
第3日目(8月30日)(セッション名後はオーガナイザー名)

	A室	B室	C室	D室	E室	F室	
8:40							8:40
9:00	<p>【ラッピング・ポリッシング・CMPの原理と応用(1)】 (鈴木恵友, 榎本俊之, 林 偉民) 座長: 鈴木恵友 A29 紫外線励起加工の研究 (第26報) -XAFS/XPS分析による天然ダイヤモンドの研磨現象の追究- ○田中武司, 滝沢俊, 齋藤男(立命館大学)</p>	<p>【光・ビームによる加工技術(1)】 (比田井洋史, 池野順一, 古本達明, 細野高史) 座長: 関紀旺 B29 SiCのレーザーライニング レーザ走査方向によるへき開伸展への影響 ○山田洋平, 池田知陽, 池野順一(埼玉大学)</p>			<p>【技術・技能教育(1)】 (伊藤伸英, 澤 武一) 座長: 伊藤伸英 E29 システム思考を鍛える学科横断での実践型授業『創る』 ○酒井康徳(芝浦工業大学)</p>	<p>【プラスト・バレル加工の最新線(1)】 (嶋田慶太, 深川 仁, 南部紘一郎, 宮島敏郎) 座長: 宮島敏郎 F29 パウダージェットデポジションの審美歯科治療への応用 ○本郷那美, 山本浩己, 富江瑛彦, 泉田一賢, 佐々木啓一, 嶋田慶太, 水谷正義, 厨川常元(東北大学)</p>	9:00
9:20	<p>A30 両面研磨におけるキャリア内でのウェハオフセット量が研磨特性に及ぼす影響の解析的検討 ○橋本洋平, 尾崎俊, 古本達明, 細川晃(金沢大学)</p>	<p>B30 石英ガラスのレーザーライニング ○小室友, 齋藤雅文, 山田洋平, 池野順一(埼玉大学)</p>	<p>【工作機械の知能化・CAM(1)】 (金子順一, 猪狩龍樹, 高杉敬吾, 齋藤明徳) 座長: 金子順一, 齋藤明徳 C30 匠の技を駆使して切削を極める加工のマイスターへ ○櫻井大樹((株)C&Gシステムズ)</p>	<p>【磁界・電界砥粒制御による次世代加工技術(1)】 (野村光由, 郷 聡華, 川久保英樹) 座長: 野村光由 D30 変動磁場を利用した超精密磁気研磨法に関する研究 -加工メカニズムの検討- ○謝惠君, 郷聡華(宇都宮大学)</p>	<p>E30 防衛大学校における技能・技術教育 ○北嶋孝之, 吉富健一郎, 猪狩龍樹(防衛大学校)</p>	<p>F30 SKD611に対する再ショットピーニングの影響調査 ○黒川敦貴, 小林祐次, 松井彰則(新東工業(株))</p>	9:20
9:40	<p>A31 弾性パッドを用いたサファイアの高速鏡面加工に関する研究 ○相内洋, 山田洋平, 池野順一(埼玉大学), 阿部健, 真野稔正(アイオン(株))</p>	<p>B31 ビコ秒レーザーの開発とダイヤモンド内部変質への応用 ○佐藤正隆, 比田井洋史, 松坂社太, 千葉明, 森田昇(千葉大学)</p>	<p>C31 デジタルシボを利用した樹脂成形型製作に関する研究 ○和合健(岩手県工業技術センター), 千田征樹((株)北上精密)</p>	<p>D31 金属積層造形チタン合金の研磨加工条件が磁気研磨レート向上に及ぼす影響 ○平野貴大, 古本辰也, 上坂裕之(岐阜大学)</p>	<p>E31 バフ研磨技術のデジタル化・見える化 -匠の技術プロジェクト報告1- ○松澤正明, 矢内俊一, 鳥塚史郎(兵庫県立大学)</p>	<p>F31 アブレイシブジェットによるマイクロ形状制御パターンニング 第2報:スリットによる微細スロープ動圧の高精度化- ○和田大智, 中前翔太, 児玉結幸, 大橋一仁(岡山大学)</p>	9:40
10:00	<p>A32 スモルトツール研磨加工における除去能率の安定性向上 ○佐竹うらら, 榎本俊之, 宮川鉄平, 大佐拓也(大阪大学), 中川英則, 舟橋克哉(キヤノン(株))</p>	<p>B32 CO₂レーザーを利用したガラス基板端部の鏡面加工とその応用技術 ○矢代直人, 山田洋平, 池野順一(埼玉大学), 東修平, 滝澤利雄(HOYA(株))</p>	<p>C32 アブレイシブウォータージェットによるマルチマテリアルの切断特性 CAMシステムのための噴流モデルの簡略化 ○齋藤明徳, 織茂健太, 吉澤優(日本大学)</p>	<p>D32 磁気援用表面改善法に関する研究 回転磁場の傾斜による影響 ○川久保英樹, 佐藤運海(信州大学), 村田修一(長野県産業労働部)</p>	<p>E32 付加製造技術を活用したものづくり教育 ○松本宏行, 高橋正明(ものつくり大学)</p>	<p>F32 噴射加工によるめっきのエロージョン・はく離現象の時系列的評価 ○佐々木慶徳, 亀山雄高, 佐藤秀明, 眞保良吉(東京都市大学)</p>	10:00
10:20	<p>A33 ラッピング加工に用いられる超微粒子ダイヤモンドとその応用技術 SiC基板の両面同時ラッピング加工技術 ○清水真吾, 佐藤洋, 笹井祐和, 道藤勉(日本エングス(株))</p>	<p>B33 レーザライニング面における加工変質層の修復技術 ○石丸友己, 山田洋平, 池野順一(埼玉大学)</p>	<p>C33 プラントへの機器搬入計画支援システムの開発 ○中村隆之, 金子順一, 阿部壮志, 堀尾健一郎(埼玉大学)</p>	<p>D33 電界砥粒制御による工具刃先での砥粒の動きとその影響 ○田中浩(愛知工業大学), 川瀬高嗣((株)小林機械製作所), 赤上陽一(秋田県産業技術センター)</p>	<p>E33 青山学院大学理工学部におけるものづくり技能教育 ○藤本正和, 高橋清, 長谷川大祐, 長秀雄(青山学院大学)</p>	<p>F33 ジャイロ式バレル研磨における接触力の基礎検討 ○伊藤巧馬, 橋本洋平, 中山友吾, 古本達明, 小谷野智広, 細川晃(金沢大学)</p>	10:20
10:40	***** 休 憩 *****						10:40
11:00	<p>【ラッピング・ポリッシング・CMPの原理と応用(2)】 座長: 榎本俊之 A34 難加工基板研磨における水酸化フラーレン結合型ハイブリッド微粒子に関する研究 ○久吉敏也, 吉本裕, 高崎寛子, 安永卓夫, Matthaphon Bun-Athuek, Panart Khajornrungruang, 鈴木恵友(九州工業大学)</p>	<p>【光・ビームによる加工技術(2)】 座長: 天本祥文 B34 ガラス中の金属球マニピュレーションにおける金属球移動軌跡の光学分析 ○今関大一, 比田井洋史, 松坂社太, 千葉明, 森田昇(千葉大学)</p>	<p>【工作機械の知能化・CAM(2)】 座長: 齋藤明徳 C34 低剛性物体の切削抵抗による変形を考慮した工具姿勢計画 ○大熊俊輝, 金子順一, 阿部壮志, 堀尾健一郎(埼玉大学)</p>	<p>【磁界・電界砥粒制御による次世代加工技術(2)】 座長: 川久保英樹 D34 磁気混合流体(MCF)研磨における高精度仕上げ-α-セルロースが研磨性能に及ぼす影響- ○野中健太, 野村光由, 藤井達也, 鈴木庸久(秋田県立大学), 呉勇波(南方科技大)</p>	<p>【技術・技能教育(2)】 座長: 酒井康徳 E34 マイクロ・ナノの世界を知る 体験型授業の試み ○山田洋平, 池野順一(埼玉大学)</p>	<p>【プラスト・バレル加工の最新線(2)】 座長: 嶋田慶太 F34 AIH-FPP処理システムを用いた投射粒子成分の移着および拡散によるTi-Al金属間化合物の形成 ○武末裕吾(京都工芸繊維大学), 渡邊一敬(慶應義塾大学), 三原佳孝(高周波熱線(株)), 小茂馬潤(慶應義塾大学)</p>	11:00
11:20	<p>A35 ダイヤモンドシートを用いたガラス基板の固定砥粒研磨の研究 -複数種類のクーラントを用いた研磨特性に対する影響分析- ○馬野公直, 畠田道雄(金沢工業大学)</p>	<p>B35 レーザ照射によってガラス内部に導入される金属球と気泡の挙動の解明 ○今井拓哉, 西岡宣泰, 比田井洋史, 松坂社太, 千葉明, 森田昇(千葉大学)</p>	<p>C35 複雑形状金型加工における経路点間隔を考慮に入れた工具経路生成アルゴリズムの開発 ○齋藤勇樹, 金子順一(埼玉大学)</p>	<p>D35 電界砥粒制御技術を活用したオパールベーススラリーの砥粒分布挙動について ○池田洋, 奈良泰七, 三浦辰徳(秋田工業高等専門学校), 久住孝幸, 越後谷正見, 赤上陽一(秋田県産業技術センター)</p>	<p>E35 茨城大学におけるものづくり人材育成 機械システム工学実習 IIの紹介 ○倉本繁, 山崎和彦, 伊藤伸英(茨城大学)</p>	<p>F35 プラスト加工面の接着力におよぼすRSmの影響 ○内海裕介, 福井瑛里((株)不二製作所), 南部紘一郎(豊田工業大学)</p>	11:20
11:40	<p>A36 コンディショナにおける砥粒の配列と形状が研磨パッド表面性状に及ぼす影響 ○田畑拓郎, 畠田道雄(金沢工業大学)</p>	<p>B36 廃シリコン粉末へのナノ秒パルスレーザー照射によるナノ粒子生成 ○百木航, 関紀旺(慶應義塾大学)</p>	<p>C36 積層造形後の除去プロセスを考慮したサポート形状の計画手法 ○小島雄太, 神永昂周, 金子順一, 阿部壮志, 堀尾健一郎(埼玉大学)</p>	<p>D36 電界砥粒制御技術を活用した先進結晶材基板の高効率ラップ技術に関する検討 ○千葉翔梧((株)斎藤光学製作所, 秋田大学), 久住孝幸, 赤上陽一(秋田県産業技術センター), 野老山貴行(名古屋大学)</p>	<p>E36 京都工芸繊維大学におけるものづくり教育 ○山口桂司(京都工芸繊維大学)</p>	<p>F36 ショットプラスト処理により形成された表面粗さが金属材料の撥水-親水性におよぼす影響 ○南部紘一郎, 佐野文哉(豊田工業大学), 内海祐介((株)不二製作所), 奥宮正洋(豊田工業大学)</p>	11:40
12:00	<p>A37 3D加工用研削工具の挙動観察とその評価 ○市山諒一, 畠田道雄(金沢工業大学), 堀田和利, 森永均((株)フジインコーポレーテッド), 石川憲一(金沢工業大学)</p>	<p>B37 エパネッセント光を採用したエッチングに関する研究 ○齋藤賢亮, 比田井洋史, 松坂社太, 千葉明, 森田昇(千葉大学)</p>	<p>C37 多方向からの光学計測結果を統合する工具形状推定手法の開発 ○金子真由美, 神永昂周, 金子順一(埼玉大学), 片野清彦(倉敷機械(株)), 阿部壮志, 堀尾健一郎(埼玉大学)</p>	<p>E37 工学部学生のための科学技術史 ○池野順一, 山田洋平(埼玉大学)</p>	<p>F37 ショットプラスト処理材に対する3次元測定を利用した非破壊検査技術の開発 ○南部紘一郎, 佐野文哉, 奥宮正洋(豊田工業大学)</p>	12:00	
12:20	***** 昼 食 *****						12:20
12:40							12:40
13:20	奨励賞受賞者記念講演 (1号館3F 301教室)						13:20

パネル展示・研究公開・カタログ展示

14.20	***** 休憩 *****						開・カ タ・ラ タ ロ グ 展 示 ・ 研 究 公	14.20
14.40	<p>【ラッピング・ポリシング・CMPの原理と応用(3)】 座長：畠田道雄 A39 自転/公転型研磨法によるスキャン研磨解析の検討 ○王寅、林偉民(群馬大学)</p>	<p>【光・ビームによる加工技術(3)】 座長：比田井洋史 B39 超硬合金に対するフェムト秒パルスレーザーを用いた微細加工 ～形状創成と平滑化～ ○天本祥文、仙波卓弥(福岡工業大学)</p>	<p>【新砥粒の開発と応用】 (藤本俊一、市田良夫) 座長：市田良夫、藤本俊一 C39 高効率鏡面研磨用砥粒MeCCAの開発 硬質結晶材料に対する湿式研磨性能評価 ○藤本俊一(アサヒ化成工業(株))</p>	<p>【高性能切削工具の開発と応用】 (岡田将人、矢部和寿、村上大介) 座長：矢部和寿 D39 高圧クーラントを用いた難削材の旋削加工 -クーラント供給面の影響- ○桑原佳月、細川晃、小谷野智広、古本達明、橋本洋平(金沢大学)</p>	<p>【技術・技能教育(3)】 座長：澤武一 E39 ものづくり教育のための教育効果評価法による教育効果 ○孕石泰文、石田和義、牧野浩二、堀内宏、寺田英嗣(山梨大学)</p>	<p>【ナノ精密・ELID加工】 (片平和俊、伊藤伸英、小野照子、江面篤志) 座長：江面篤志 F39 ELID研削におけるファインパブルの挙動と効果 ○渡邊寛、伊藤伸英、坂本健、稲澤勝史(茨城大学)、大森整(理化学研究所)</p>	14.40	
15.00	<p>A40 金属含有多孔質定盤の研磨効果の検討 ○寒河江泰崇、林偉民(群馬大学)、鹿野達也、儀義宣(アイオン(株))</p>	<p>B40 高出力レーザー援用研削による難削材の加工性能に関する研究 ○高橋廣生、橋本知弥、松浦寛(東北学院大学)、菜嶋理(株)ファーストクラスライト)</p>	<p>C40 人造高純度C60のガラス研磨への適応 ○森和生、坂本愛、樋山篤慶、山田洋平、池野順一(埼玉大学)</p>	<p>D40 ボロンドープダイヤモンドを利用したPCD工具による難加工材の切削加工 第3報：刃先性状と切削性能 岩井学、○小林拓矢(富山県立大学)、内山文宏(株)内山刃物、Peter CHEN、Bear LIN(FACT江信有限公司)、二ノ宮進一(日本工業大学)</p>	<p>E40 科学体験教材開発 コイルばねづくり ○小林志好、中村正人、杉本裕代、伊藤通子(京都市大学)</p>	<p>F40 ツインノズルPELIDを用いたナノダイヤ含有ファイバー砥石の開発 ○石塚聖輝、伊藤伸英、稲澤勝史(茨城大学)、大森整、加藤照子(理化学研究所)、梅澤信二郎(早稲田大学)</p>	15.00	
15.20	<p>A41 サファイアウエハの高回転・高圧研磨における摩擦特性 ○小野澤哲郎、吉富健一郎、宇根篤暢(防衛大学校)</p>	<p>B41 レーザ焼入れフォーミングとナノファイバー研磨によるその表面仕上げ ○真鍋裕輝、西田大陸、呉魏、廣垣俊樹、青山栄一(同志社大学)</p>	<p>C41 機能性砥粒の作用形態と研磨性能との関連 ○後藤崇将、北嶋将太、佐藤誠((株)ノリタケカンパニーリミテド)</p>	<p>D41 工具用単結晶ダイヤモンドの不純物状態と摩耗特性 ○李真和、真鍋佳典、寺本三記、原野佳津子、小林豊、角谷均(住友電気工業(株))</p>	<p>E41 学生と共に取り組んだ「ものづくり」技術と技能(理工系学生と共に各種大会出場を目指して取り組む出場機材の設計・製作を通して実施した「ものづくり」のための技術向上、技能向上への挑戦) ○西村一郎(東京電機大学)、河西敏雄(埼玉大学)、伊藤伸英(茨城大学)、澤武一(芝浦工業大学)、藤田壽憲(東京電機大学)</p>	<p>F41 Uncertainty analysis of roundness measurement of a small cylinder based on the stitching linear-scan method ○李橋林、齋藤俊樹、町田裕貴、松隈啓、清水裕樹、高偉(東北大学)</p>	15.20	
15.40	<p>A42 サファイア基板の高回転研磨における研磨バッド温度・摩擦特性 ○吉富健一郎、宇根篤暢(防衛大学校)</p>	<p>B42 砥石回転数がレーザー援用研削加工の結果に与える影響 ○菊池祥平、堀尾克己、松浦寛(東北学院大学)、菜嶋理((株)ファーストクラスライト)</p>	<p>C42 ナノ多結晶cBN砥粒の単粒研削における摩耗特性 ○市田良夫(宇都宮大学)、大藤弘明、入船徹男、國本健広(愛媛大学)</p>	<p>D42 ダイヤモンドコーテッドエンドミルにより得られた超硬合金の直彫り加工面の表面性状評価 ○岡田将人、近藤達行(福井大学)、新谷正義(金沢大学)、渡邊英人(ユニオンツール(株))、三浦拓也、大津雅亮(福井大学)</p>	<p>E42 群馬大学理工学部でのものづくり教育事例紹介 ○林偉民(群馬大学)</p>	<p>F42 摩擦係数にもとづく目立て、目つぶれ状態の分類機械学習を用いた砥粒状態の分類への適用 ○春日博、加藤照子、上原嘉宏(理化学研究所)、齋藤健汰(ものづくり大学)、大森整(理化学研究所)</p>	15.40	
16.00	<p>A43 セオライトの添加によるガラス研磨における洗浄性の向上 ○遠藤秀一、吉田徹、正野晶久、笠松裕史(ジークライト(株))、谷泰弘((株)ツールバンク)</p>					<p>F43 微量滴下タイプイオン化クーラントシステムによる電解ナノカーボン切削液の潤滑特性 ○上原嘉宏、加藤照子、大森整(理化学研究所)、松澤隆(池上金型工業(株))、伊藤伸英(茨城大学)</p>	16.00	
16.20								16.20